

# 英飞凌 CIPOS™ Mini IPM

## 英飞凌 IM06B50GC1, 600 V 50 A CIPOS™ Mini IPM

### 描述

CIPOS™ Mini IPM IM06B50GC1模块系列集成了各种功率和控制组件，以提高可靠性、优化 PCB 尺寸和系统成本。它专为控制变速驱动装置中的三相电机而设计。它有适用于功率电路的封装，能提供良好的热传导和电气隔离，以及低的 EMI干扰和过载保护。为了实现出色的电气性能，英飞凌将领先的 TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管与优化的 SOI 栅极驱动器相结合。

### 特性

#### 封装

- 完全隔离的双列直插式 (DIL) 塑封模块
- 无铅的管脚镀层；符合RoHS标准

#### 逆变器

- 650 V TRENCHSTOP™ IGBT7 T7
- 600V 坚固耐用的 SOI 栅极驱动器技术，面对瞬态电压和负电压具有稳定性
- 在  $V_{BS} = 15V$  时，允许的负  $V_s$  电位最高为  $-11V$ ，用于信号传输
- 集成自举功能
- 过流关断
- 内置NTC热敏电阻用于温度监控
- 所有通道均具有欠压锁定功能
- 低侧发射极引脚可用于相电流监控（发射极开路）
- 防桥臂直通
- 保护期间，所有6个开关均关断



### 潜在应用

- 空调
- 热泵应用
- 家用电器
- 电机驱动

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 [infineon.com](http://infineon.com) 参考最新的英文版本（控制文档）。

产品验证

产品验证

符合JEDEC47/20/22相关的工业应用要求

表1 产品信息

Base Part Number	Package Type	Standard Pack		Remarks
		Form	MOQ	
IM06B50GC1	DIP 36x21D	14 pcs / Tube	280 pcs	

目录

目录

描述 .....	1
特性 .....	1
潜在应用 .....	1
产品验证 .....	2
目录 .....	3
<b>1 内部电气原理图 .....</b>	<b>4</b>
<b>2 引脚说明 .....</b>	<b>5</b>
2.1 引脚分配 .....	5
2.2 引脚说明 .....	6
<b>3 绝对最大额定值 .....</b>	<b>8</b>
3.1 模块部分 .....	8
3.2 逆变器部分 .....	8
3.3 控制部分 .....	8
<b>4 热特性 .....</b>	<b>9</b>
<b>5 建议应用条件 .....</b>	<b>10</b>
<b>6 静态参数 .....</b>	<b>11</b>
6.1 逆变器部分 .....	11
6.2 控制部分 .....	11
<b>7 动态参数 .....</b>	<b>12</b>
7.1 逆变器部分 .....	12
7.2 控制部分 .....	12
<b>8 热敏电阻 .....</b>	<b>13</b>
<b>9 机械特性和额定值 .....</b>	<b>14</b>
<b>10 资质信息 .....</b>	<b>15</b>
<b>11 图表 .....</b>	<b>16</b>
11.1 $T_C$ 测量点 (俯视图) .....	16
11.2 背面曲率测量点 .....	16
11.3 开关测试电路 .....	18
11.4 开关时间的定义 .....	17
<b>12 应用指南 .....</b>	<b>18</b>
12.1 典型应用示意图 .....	18
12.2 性能图表 .....	19
<b>13 封装外形尺寸 .....</b>	<b>20</b>
修订记录 .....	21

内部电气原理图

1 内部电气原理图

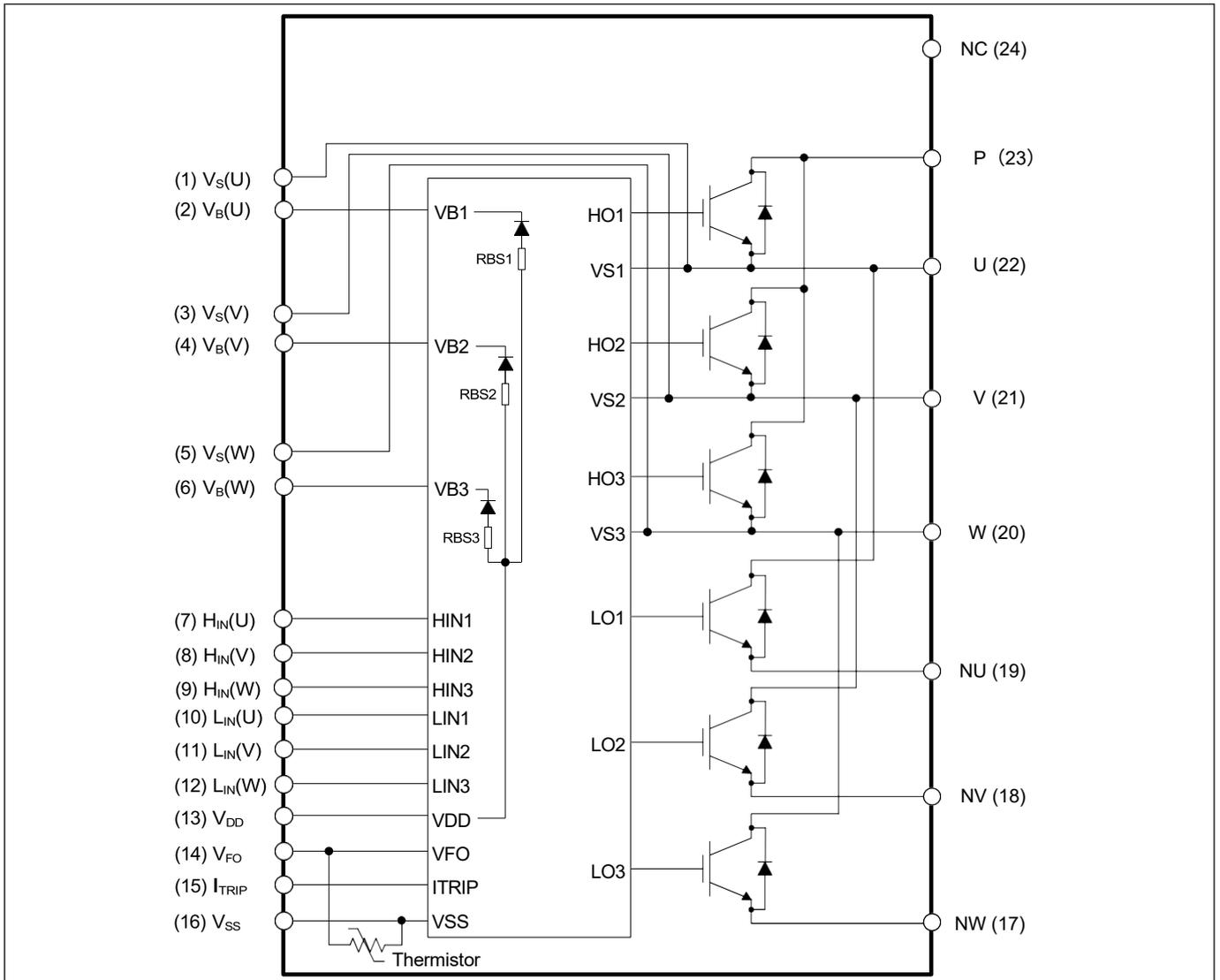


图1 内部电路原理图

引脚说明

## 2 引脚说明

### 2.1 引脚分配

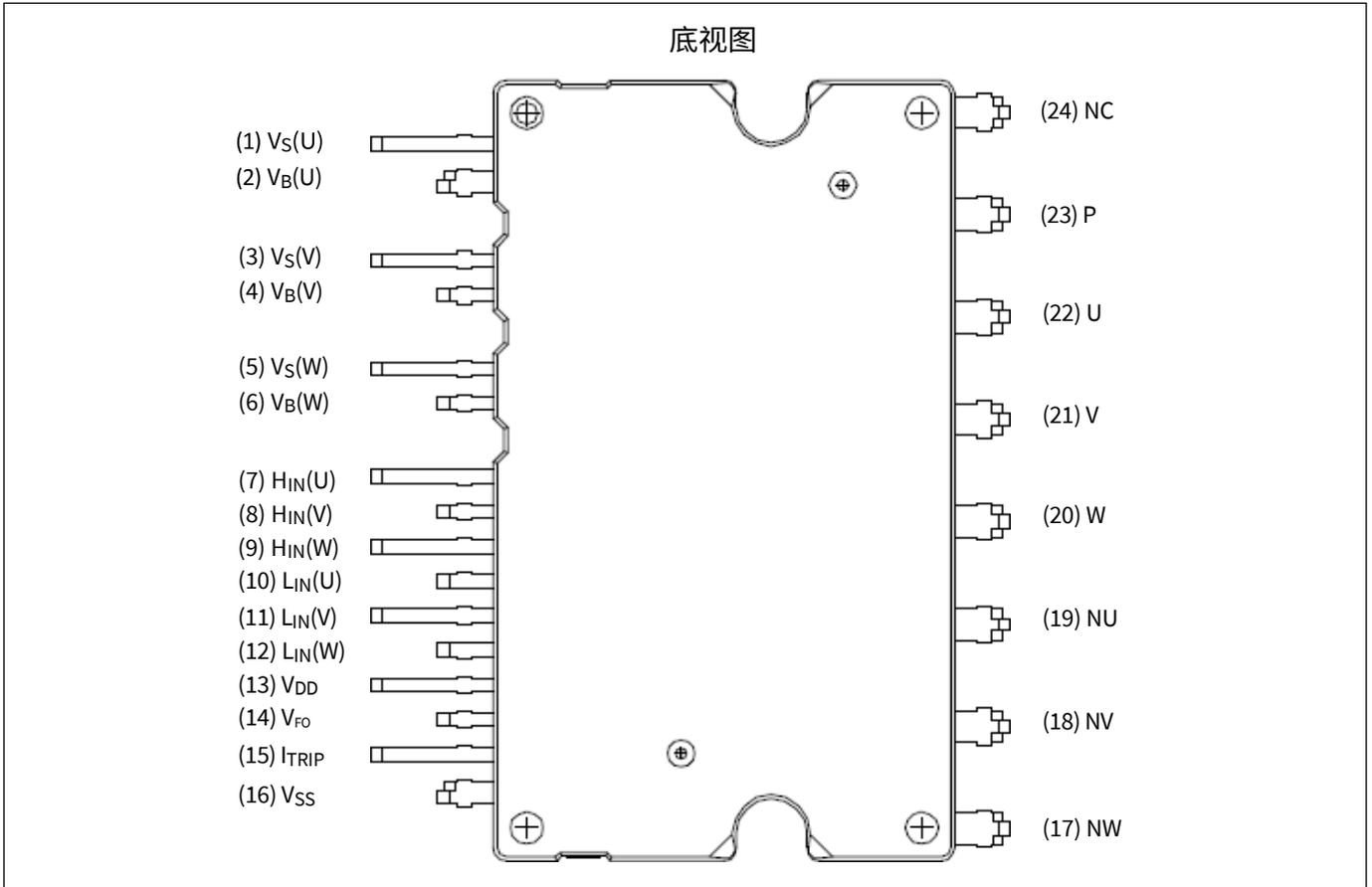


Figure 2 Pin assignment

Table 2 Pin assignment

Pin number	Pin name	Pin description
1	$V_S(U)$	U-phase high-side floating IC supply offset voltage
2	$V_B(U)$	U-phase high-side floating IC supply voltage
3	$V_S(V)$	V-phase high-side floating IC supply offset voltage
4	$V_B(V)$	V-phase high-side floating IC supply voltage
5	$V_S(W)$	W-phase high-side floating IC supply offset voltage
6	$V_B(W)$	W-phase high-side floating IC supply voltage
7	$H_{IN}(U)$	U-phase high-side gate driver input
8	$H_{IN}(V)$	V-phase high-side gate driver input
9	$H_{IN}(W)$	W-phase high-side gate driver input
10	$L_{IN}(U)$	U-phase low-side gate driver input
11	$L_{IN}(V)$	V-phase low-side gate driver input
12	$L_{IN}(W)$	W-phase low-side gate driver input
13	$V_{DD}$	Low-side control supply
14	$V_{FO}$	Fault output / temperature monitor
15	$I_{TRIP}$	Overcurrent shutdown input

引脚说明

Pin number	Pin name	Pin description
16	V <sub>SS</sub>	Low-side control negative supply
17	NW	W-phase low-side emitter
18	NV	V-phase low-side emitter
19	NU	U-phase low-side emitter
20	W	Motor W-phase output
21	V	Motor V-phase output
22	U	Motor U-phase output
23	P	Positive bus input voltage
24	NC	No connection

2.2 引脚说明

**HIN(U, V, W) 和 LIN(U, V, W) (低压侧和高压侧控制引脚, 引脚 7 - 12)**

这些引脚是正逻辑, 负责控制集成 IGBT。它们的施密特触发输入阈值可确保 LSTTL 和 CMOS 兼容, 控制器输出电压可低至 3.3 V。内部提供约 5 kΩ 的下拉电阻, 以便在电源启动时对输入端进行预偏置。

提供夹子以保护引脚。负脉冲绝对最小值为 -5.5 V。

可提供出色的坚固性。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。

噪声滤波器抑制短于滤波时间  $t_{FIL,IN}$  的控制脉冲。图 4 说明了滤波器的工作原理。不建议使用短于 1 μs 的输入脉宽。

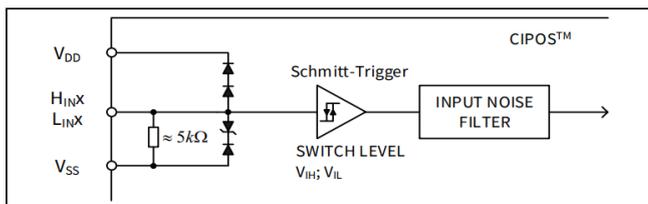


Figure 3 Input pin structure

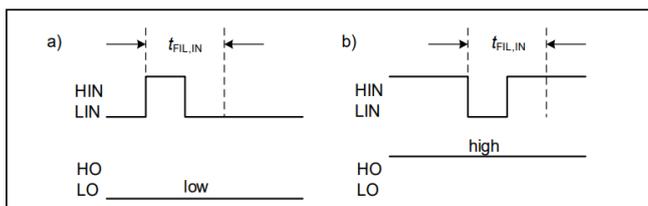


Figure 4 Input filter timing diagram

集成栅极驱动器还提供了防止直通的功能, 可避免同一桥臂上下管同时导通 (即当同一管脚的两个输入被激活时, 只有最先被激活的输入被激活, 从而使该管脚稳定地保持在安全状态。驱动器还提供典型值为 360 ns 的最短死区时间, 以减少上下桥臂的 IGBT 的交叉导通。

**V<sub>FO</sub> (故障输出和 NTC, 引脚 14)**

当引脚 V<sub>DD</sub> 欠压或 ITRIP 触发过流检测时, V<sub>FO</sub> 引脚将指示模块故障。FO 引脚需要外部上拉电阻。

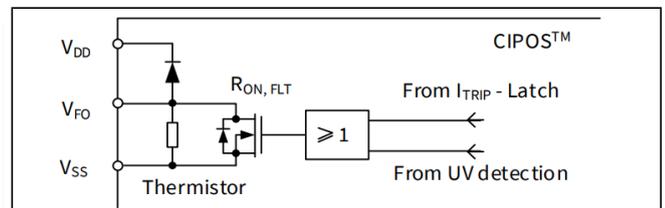


Figure 5 Internal circuit at pin V<sub>FO</sub>

每次触发 ITRIP 或欠压锁定后, 都会激活睡眠功能。故障清除时间过后, 必须输入新的边沿输入信号才能激活栅极驱动。

**ITRIP (过流检测功能, 引脚15)**

该产品系列通过将 ITRIP 输入连接至 IGBT 电流反馈提供过流检测功能。ITRIP 比较器阈值 (典型值 0.525 V) 以 V<sub>SS</sub> 为基准。输入噪声滤波器 ( $t_{TRIP}$  = 典型值 530 ns) 可防止驱动器检测到错误的过流事件。

## 引脚说明

过流检测会触发栅极驱动器关闭输出。功能允许低侧输出比高侧输出关闭速度快约 200 ns。

故障清除时间设置为最小 100  $\mu$ s。

### **V<sub>DD</sub>** , **V<sub>SS</sub>** (低侧控制电源和参考地, 引脚 13、16)

V<sub>DD</sub>为控制电源, 为输入逻辑和输出级供电。输入逻辑以 V<sub>SS</sub>地为参考。

当电源电压超过典型电压 V<sub>DDUV+</sub> = 12.4 V 时, 欠压保护电路可使芯片通电运行。

当 V<sub>DD</sub>电源电压低于 V<sub>DDUV-</sub> = 11.5 V 时, 栅极驱动器会关闭所有输出。这可防止 IGBTs 在栅极电压水平过低时导通, 从而防止功率耗散过大。

### **V<sub>B</sub>(U, V, W)** 和 **V<sub>S</sub>(U, V, W)** (高端电源, 引脚 1 - 6)

V<sub>B</sub>至 V<sub>S</sub>为高端驱动电源电压。高端驱动电路电压相对于 V<sub>SS</sub>浮动, 它只跟随高端 IGBT 发射极电压。

由于功耗低, 浮动驱动级由芯片内集成的自举电路供电。

欠压保护电路的电压设置, 上升阈值典型值为 V<sub>BSUV+</sub> = 11.5 V, 下降阈值典型值为 V<sub>BSUV-</sub> = 10.7 V。V<sub>S</sub>(U, V, W)相对于V<sub>SS</sub>具有极高的抗负电压能力, 瞬时负压耐受能力最高可达 -50 V。可确保电路稳定工作在恶劣条件下。

### **NW、NV、NU** (低侧发射极, 引脚 17 - 19)

低侧发射极可用于测量各相脚的电流。建议尽可能缩短其与 V<sub>SS</sub>引脚的连接距离, 以避免不必要的感性压降。

### **W、V、U** (高侧发射极和低侧集电极, 引脚 20 - 22)

这些引脚连接到电机 U、V、W 输入引脚

### **P** (正总线输入电压, 引脚 23)

高侧 IGBT 连接至总线电压。需要注意的是, 母线电压不超过450V。

绝对最大额定值

### 3 绝对最大额定值

(如无特别说明,  $V_{DD}=15\text{ V}$  和  $T_J=25^\circ\text{C}$ )

#### 3.1 模块部分

Description	Symbol	Condition	Value	Unit
Storage temperature range	$T_{STG}$		-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
Operating case temperature	$T_C$	Refer to Figure 7	-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
Operating junction temperature	$T_J$		-40 ~ 150	$^\circ\text{C}$
Maximum junction temperature <sup>1</sup>	$T_{J,switch,max}$		175	$^\circ\text{C}$
Isolation test voltage	$V_{ISO}$	1 min, RMS, $f = 60\text{ Hz}$	2000	V

#### 3.2 逆变器部分

Description	Symbol	Condition	Value	Unit
Max. blocking voltage	$V_{CES}$		600	V
DC link supply voltage of P-N	$V_{PN}$	Applied between P-N	450	V
DC link supply voltage (surge) of P-N	$V_{PN(surge)}$	Applied between P-N	500	V
Each IGBT collector current <sup>2</sup>	$I_C$	$T_C = 25^\circ\text{C}, T_J < 150^\circ\text{C}$	35	A
Each IGBT collector peak current <sup>1</sup>	$I_{CP}$	$T_C = 25^\circ\text{C}, T_J < 150^\circ\text{C}$ less than 1 ms	100	A
Maximum peak output current	$I_{O(peak)}$	Sine-wave, $T_C = 25^\circ\text{C},$ $f_o \geq 1\text{ Hz}$	50	A
Power dissipation per IGBT	$P_{tot}$		216	W
Short circuit withstand time	$t_{SC}$	$V_{DC} \leq 360\text{V}, T_J = 150^\circ\text{C}$	3	$\mu\text{s}$

#### 3.3 控制部分

Description	Symbol	Condition	Value	Unit
High side offset voltage	$V_S$		600	V
Repetitive peak reverse voltage of bootstrap diode	$V_{RRM}$		600	V
Module supply voltage	$V_{DD}$		-1 ~ 20	V
High-side floating supply voltage ( $V_B$ reference to $V_S$ )	$V_{BS}$		-1 ~ 20	V
Input voltage ( $L_{IN}, H_{IN}, I_{TRIP}$ )	$V_{IN}$		-1 ~ $V_{DD}+0.3$	V

<sup>1</sup>在下列条件下, 内置电源芯片的最高结温额定值为  $175^\circ\text{C}$ : 最多10秒, 每10分钟一次, 最大整个使用寿命期间累计1小时。

<sup>2</sup>脉冲宽度和周期受结温限制

## 热特性

## 4 热特性

Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Single IGBT thermal resistance, junction to case	$R_{thJC}$	See Figure 7 for $T_c$ measurement point	-	-	0.6	K/W
Single diode thermal resistance, junction-case	$R_{thJC, D}$		-	-	1.0	K/W

## 5 推荐运行条件

除非另有说明，所有电压均为以  $V_{SS}$  电位为参考的绝对电压。

Description	Symbol	Value			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
DC link supply voltage of P-N	$V_{PN}$	0	300	400	V
Low-side supply voltage	$V_{DD}$	13.0	15.0	17.5	V
High-side floating supply voltage ( $V_B$ vs. $V_S$ )	$V_{BS}$	13.0	-	17.5	V
Logic input voltages $L_{IN}$ , $H_{IN}$ , $I_{TRIP}$	$V_{IN}$ $V_{ITRIP}$	0	-	5.0	V
Inverter PWM carrier frequency	$f_{PWM}$	-	-	20	kHz
External deadtime between $H_{IN}$ and $L_{IN}$	DT	2.0	-	-	$\mu s$
Voltage between $V_{SS}$ – N (including surge)	$V_{COMP}$	-5.0	-	5.0	V
Minimum input pulse width	$PW_{IN(ON)}$ $PW_{IN(OFF)}$	1.0	-	-	$\mu s$
Control supply variation	$\Delta V_{BS}$ , $\Delta V_{DD}$	-1.0 -1.0	- -	1.0 1.0	V/ $\mu s$

静态参数

## 6 静态参数

( $V_{DD} = V_{BS} = 15\text{ V}$  和  $T_J = 25^\circ\text{C}$ , 如无特别说明)

### 6.1 逆变器部分

Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Collector-emitter voltage	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 50\text{ A}, T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 50\text{ A}, T_J = 150^\circ\text{C}$	-	1.80 2.15	2.20 -	V
Collector-emitter leakage current	$I_{CES}$	$V_{CE} = 600\text{ V}$	-	-	1	mA
Diode forward voltage	$V_F$	$I_F = 50\text{ A}, T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 50\text{ A}, T_J = 150^\circ\text{C}$	-	2.30 2.25	- -	V

### 6.2 控制部分

Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Logic "1" input voltage ( $L_{IN}, H_{IN}$ )	$V_{IH}$		1.7	2.0	2.3	V
Logic "0" input voltage ( $L_{IN}, H_{IN}$ )	$V_{IL}$		0.7	0.9	1.1	V
$I_{TRIP}$ positive going threshold	$V_{IT, TH+}$		475	525	570	mV
$I_{TRIP}$ input hysteresis	$V_{IT, HYS}$		45	70	-	mV
$V_{DD}$ and $V_{BS}$ supply undervoltage positive going threshold	$V_{DDUV+}$		11.5	12.4	13.1	V
	$V_{BSUV+}$		10.6	11.5	12.2	
$V_{DD}$ and $V_{BS}$ supply undervoltage negative going threshold	$V_{DDUV-}$		10.6	11.5	12.3	V
	$V_{BSUV-}$		9.7	10.7	11.7	
$V_{DD}$ and $V_{BS}$ supply undervoltage lockout hysteresis	$V_{DDUVH}$ $V_{BSUVH}$		0.5	0.9	-	V
Quiescent $V_{Bx}$ supply current ( $V_{Bx}$ only)	$I_{QBS}$	$H_{IN} = 0\text{ V}$	-	-	300	$\mu\text{A}$
Quiescent $V_{DD}$ supply current ( $V_{DD}$ only)	$I_{QDD}$	$L_{IN} = 0\text{ V}, H_{INX} = 5\text{ V}$	-	-	1.1	mA
Input bias current for $L_{IN}, H_{IN}$	$I_{IN+}$	$V_{IN} = 5\text{ V}$	-	1.1	1.7	mA
Input bias current for $I_{TRIP}$	$I_{ITRIP+}$	$V_{ITRIP} = 5\text{ V}$	-	68	185	$\mu\text{A}$
Input bias current for $V_{FO}$	$I_{FO}$	$V_{FO} = 5\text{ V}, V_{ITRIP} = 0\text{ V}$	-	60	-	$\mu\text{A}$
$V_{FO}$ output voltage	$V_{FO}$	$I_{FO} = 10\text{ mA}, V_{ITRIP} = 1\text{ V}$	-	0.35	-	V
Bootstrap diode forward voltage	$V_{F\_BSD}$	$I_F = 0.3\text{ mA}$	-	1.0	-	V
Bootstrap diode resistance	$R_{BSD}$	Between $V_{F1} = 4\text{ V}$ and $V_{F2} = 5\text{ V}$	-	37	-	$\Omega$

动态参数

## 7 动态参数

(如无特别说明,  $V_{DD}=15\text{ V}$  和  $T_J=25^\circ\text{C}$ )

### 7.1 逆变器部分

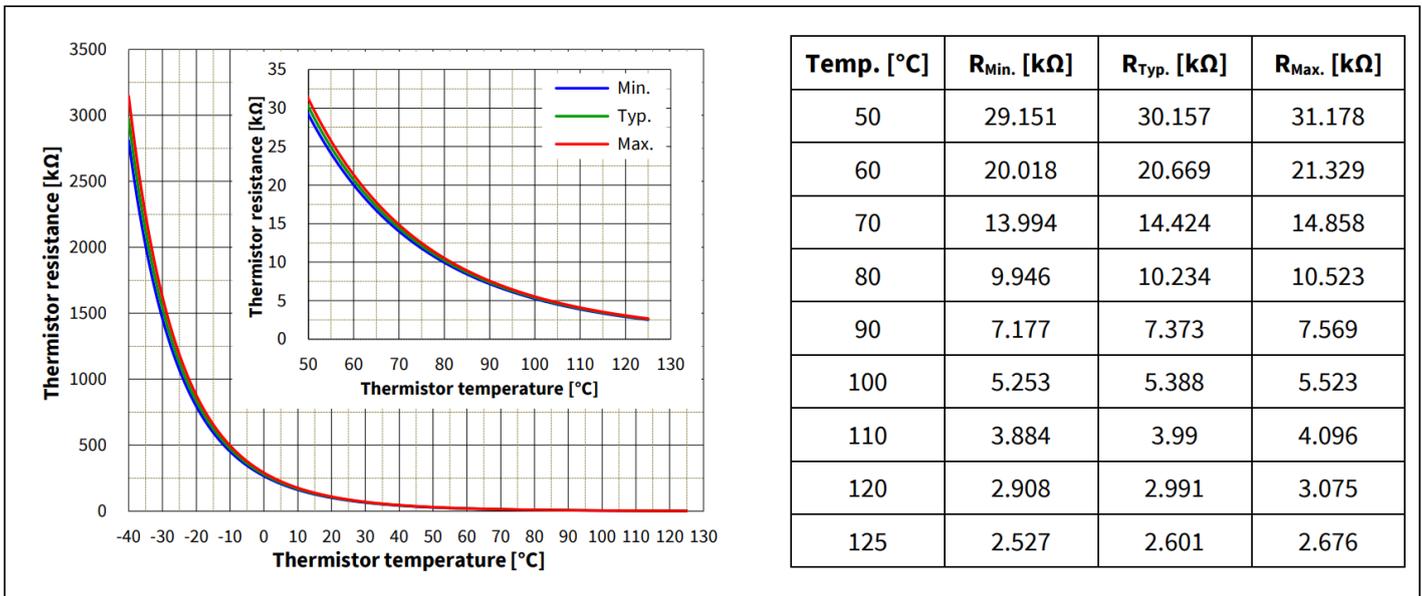
Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Turn-on propagation delay time	$t_{on}$	$V_{LIN, HIN} = 5\text{ V}$ , $I_C = 50\text{ A}$ , $V_{DC} = 300\text{ V}$	-	860	-	ns
Turn-on rise time	$t_r$		-	85	-	ns
Turn-on switching time	$t_{c(on)}$		-	285	-	ns
Reverse recovery time	$t_{rr}$		-	235	-	ns
Turn-off propagation delay time	$t_{off}$	$V_{LIN, HIN} = 0\text{ V}$ , $I_C = 50\text{ A}$ , $V_{DC} = 300\text{ V}$	-	1155	-	ns
Turn-off fall time	$t_f$		-	35	-	ns
Turn-off switching time	$t_{c(off)}$		-	110	-	ns
Short circuit propagation delay time	$t_{SCP}$	From $V_{IT, TH+}$ to 10% $I_{SC}$	-	1430	-	ns
IGBT turn-on energy (includes reverse recovery of diode)	$E_{on}$	$V_{DC} = 300\text{ V}$ , $I_C = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$	-	2460	-	$\mu\text{J}$
			-	3460	-	
IGBT turn-off energy	$E_{off}$	$V_{DC} = 300\text{ V}$ , $I_C = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$	-	1080	-	$\mu\text{J}$
			-	1525	-	
Diode recovery energy	$E_{rec}$	$V_{DC} = 300\text{ V}$ , $I_C = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$	-	145	-	$\mu\text{J}$
			-	410	-	

### 7.2 控制部分

Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Input filter time $I_{TRIP}$	$t_{ITRIP}$	$V_{ITRIP} = 1\text{ V}$	-	530	-	ns
Input filter time at $L_{IN}$ , $H_{IN}$ for turn on and off	$t_{FIL, IN}$	$V_{LIN, HIN} = 0\text{ V}$ or $5\text{ V}$	-	290	-	ns
Fault clear time after $I_{TRIP}$ -fault	$t_{FLTCLR}$		100	280	-	$\mu\text{s}$
$I_{TRIP}$ to fault propagation delay	$t_{FLT}$	$V_{LIN, HIN} = 0$ or $V_{LIN, HIN} = 5\text{ V}$ , $V_{ITRIP} = 1\text{ V}$	-	680	1000	ns
Internal deadtime	$DT_{IC}$		-	360	-	ns
Matching propagation delay time (on and off) all channels	$M_T$	External dead time > 500 ns	-	20	-	ns

## 8 热敏电阻

Description	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Resistance	$R_{NTC}$	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	-	85	-	k $\Omega$
B-constant of NTC (Negative temperature coefficient) thermistor	B (25/100)		-	4092	-	K



**Figure 6 Thermistor resistance - temperature curve and table**  
(For more information, please refer to the application note)

## 9 机械特性和额定值

Description	Condition	Value			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
Mounting torque	M3 screw and washer	0.59	-	0.78	Nm
Backside curvature	Refer to Figure 8	0	-	150	μm
Weight		-	6.60	-	g

资质信息

## 10 资质信息

<b>UL certification</b>	File number: E314539	
<b>Moisture sensitivity level</b>	-	
<b>RoHS compliant</b>	Yes (Lead-free terminal plating)	
<b>ESD</b>	HBM (human body model) class	2
	CDM (charged device model) class	C2a

图表

# 11 图表

## 11.1 T<sub>c</sub> 测量点 (俯视图)

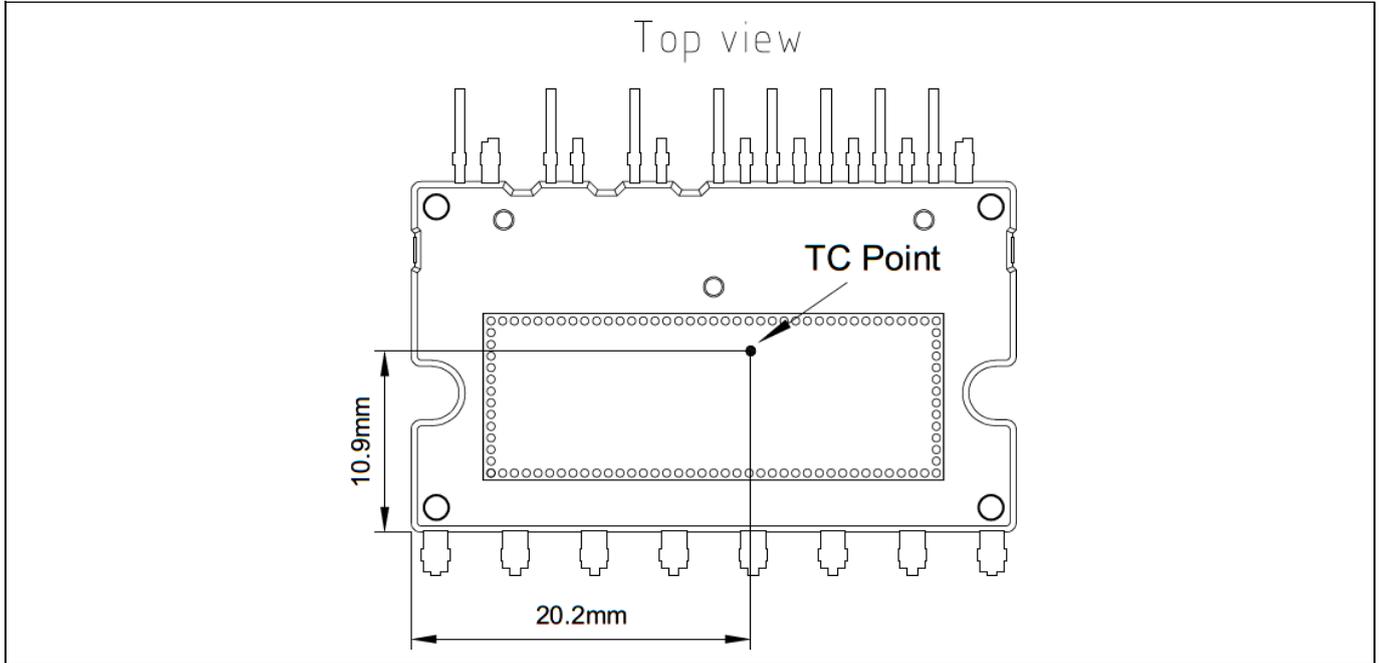


图7 T<sub>c</sub>测量点<sup>1</sup>

## 11.2 背面弯曲度测量位置

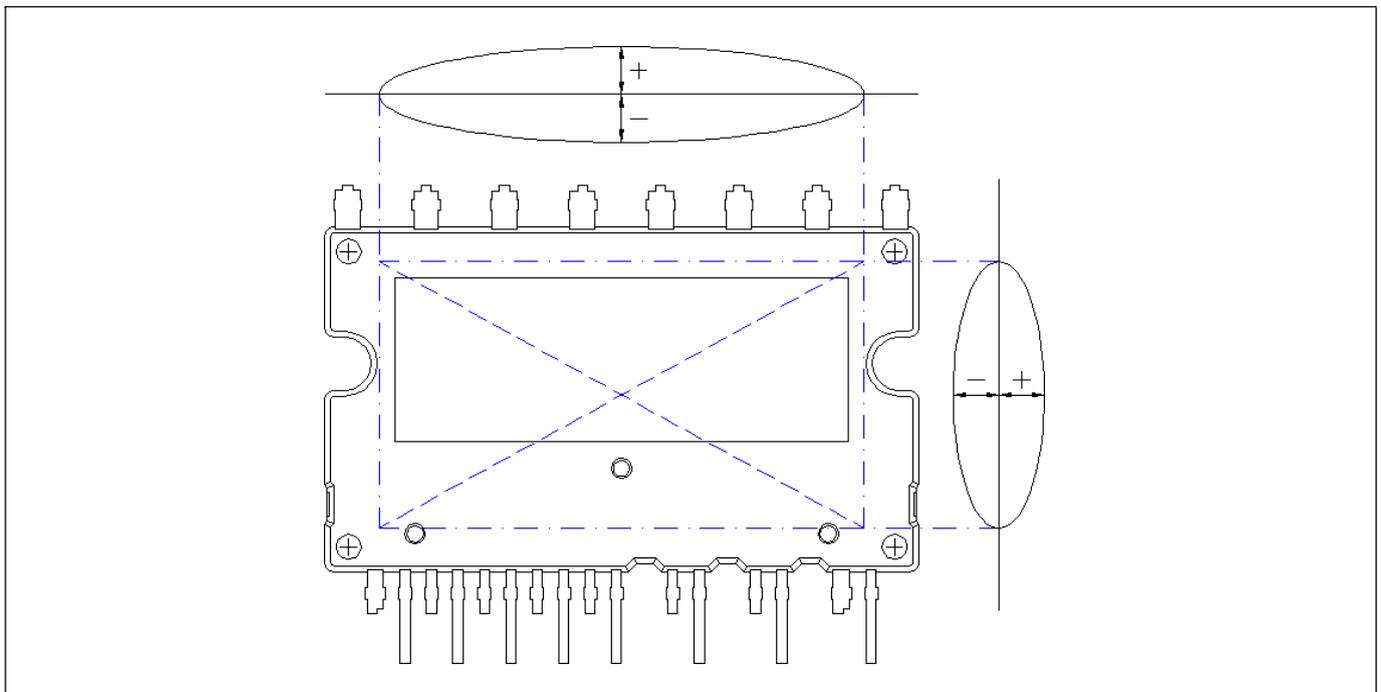


图8 背面曲率测量位置

<sup>1</sup>除图 7 中指定点之外的任何测量均与温度验证无关，并且会带来错误或不同的信息。

图表

### 11.3 开关测试电路

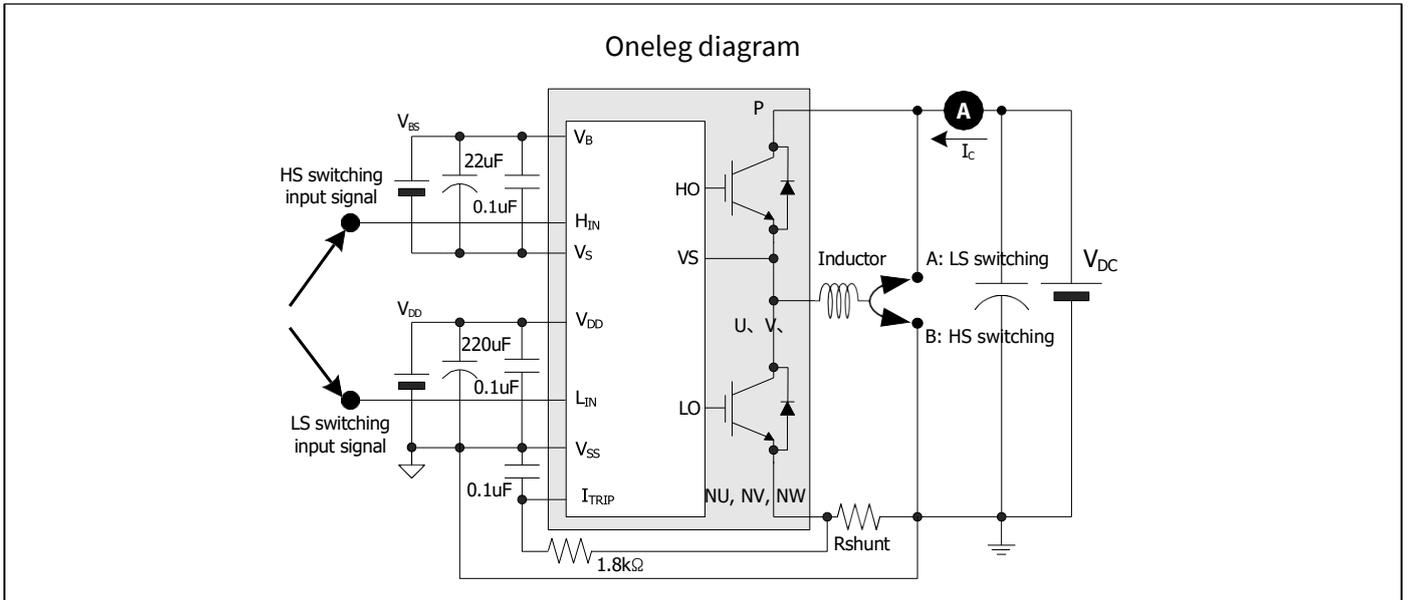


图9 开关测试电路

### 11.4 开关时间的定义

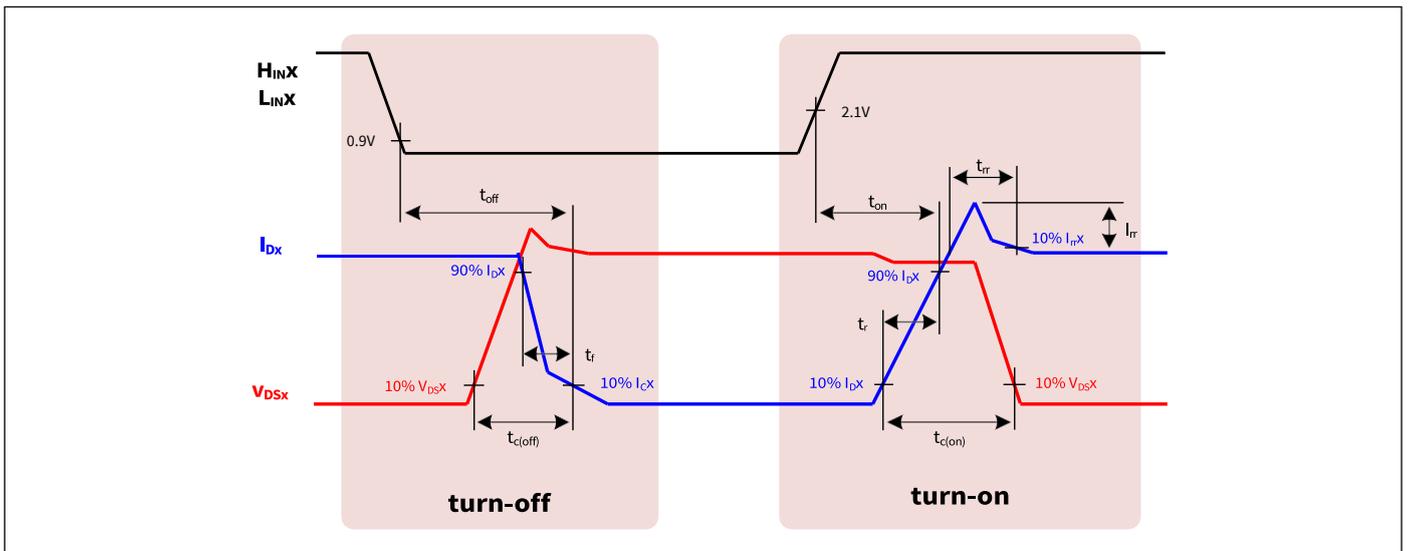


图10 开关时间定义

## 12 应用指南

### 12.1 典型应用示意图

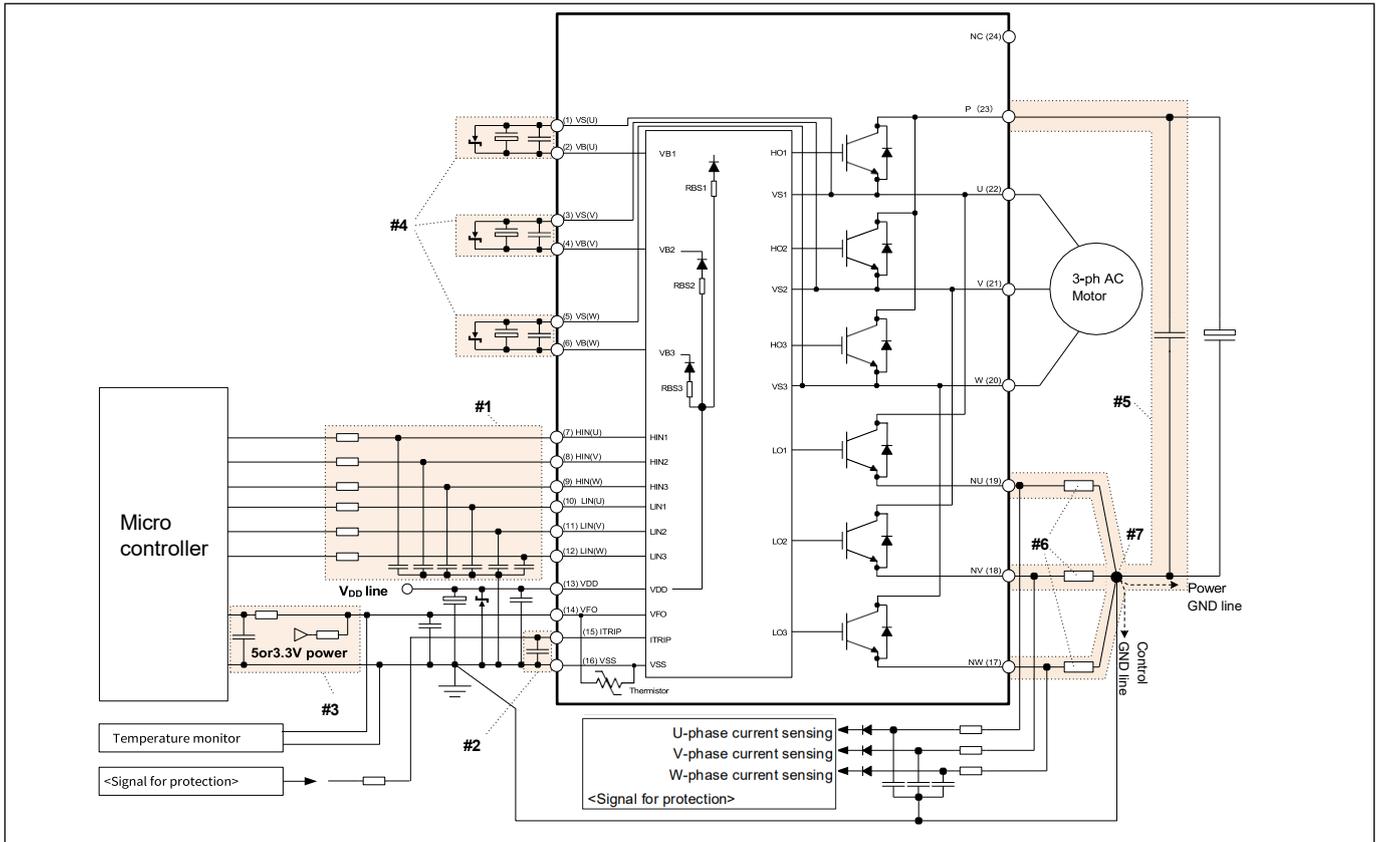


图 11 典型应用电路

- #1 输入信号电路
  - 可使用 RC 滤波电路来降低输入信号噪声（如 100 Ω、1 nF）。
  - 滤波电容器应靠近 IPM（尤其是 V<sub>SS</sub> 引脚）。
- #2 I<sub>TRIP</sub> 电路
  - 为防止保护功能出错，建议使用 RC 滤波器（1.5~2.0 μs，例如 68 Ω、22 nF）电路。
  - 滤波电容器应靠近 ITRIP 和 V<sub>SS</sub> 引脚。
- #3 V<sub>FO</sub> 电路
  - V<sub>FO</sub> 引脚为开漏输出。应使用适当的电阻器将该信号线上拉至 5 V/3.3 V 的偏置电压。
  - 建议将 RC 滤波器放置在靠近控制器的位置。
- #4 V<sub>B</sub>-V<sub>S</sub> 电路
  - 用于高压侧浮动电源电压的电容器应靠近 V<sub>B</sub> 和 V<sub>S</sub> 引脚。
- #5 吸收电容
  - IPM、吸收电容、采样电阻之间的连线应尽可能短。
- #6 电流采样电阻
  - 强烈建议使用 SMD 型电阻器，以尽量减少杂散电感。
- #7 接地线
  - 电源地和信号地应连接在一个点上。建议将它们连接在分流电阻器的末端。

12.2 性能图表

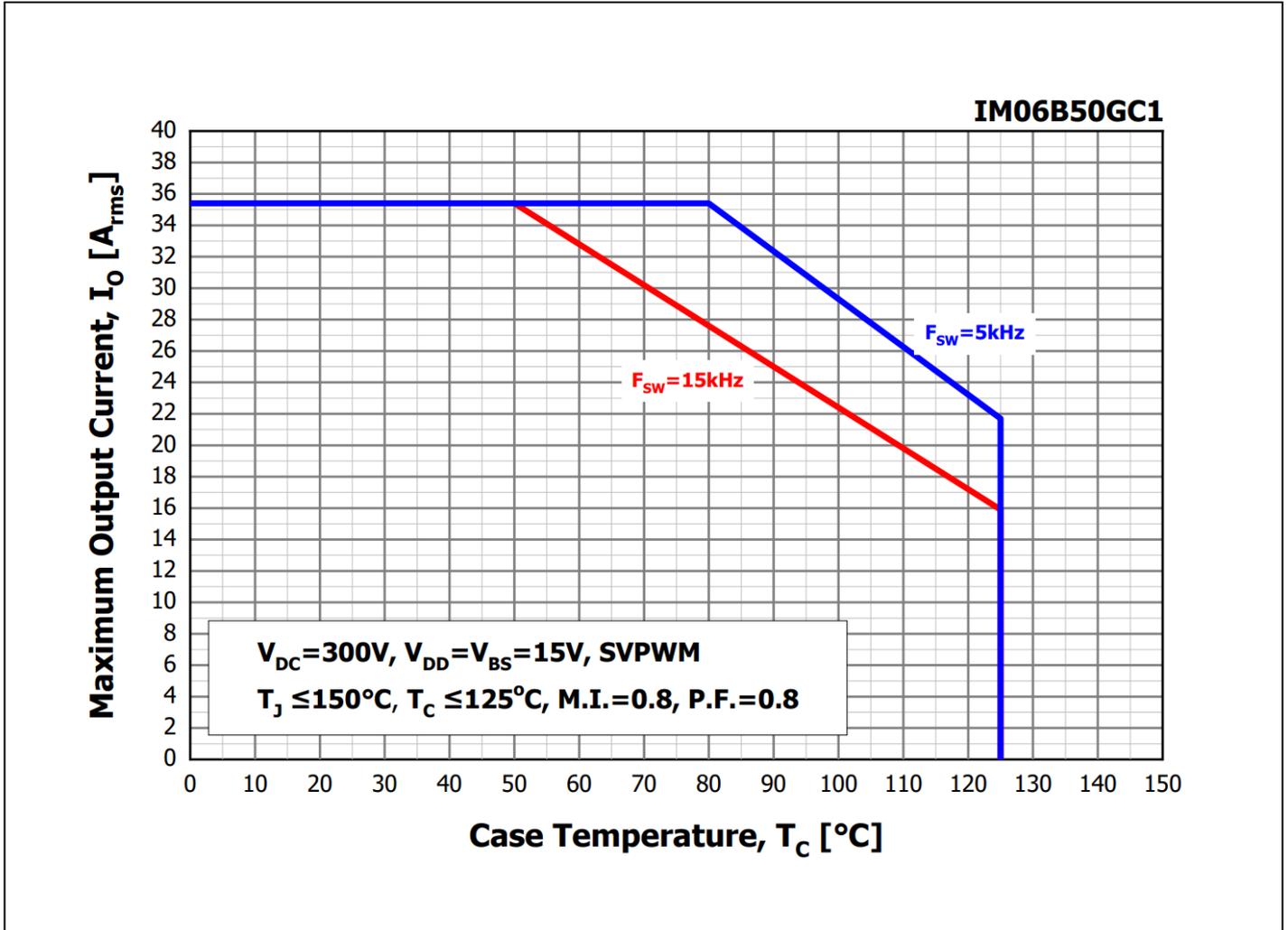


Figure 12 Maximum operating current SOA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 此最大工作电流 SOA 只是基于本产品典型特性的示例之一。它可以根据每个用户的实际运行条件进行更改。

### 13 封装外形尺寸

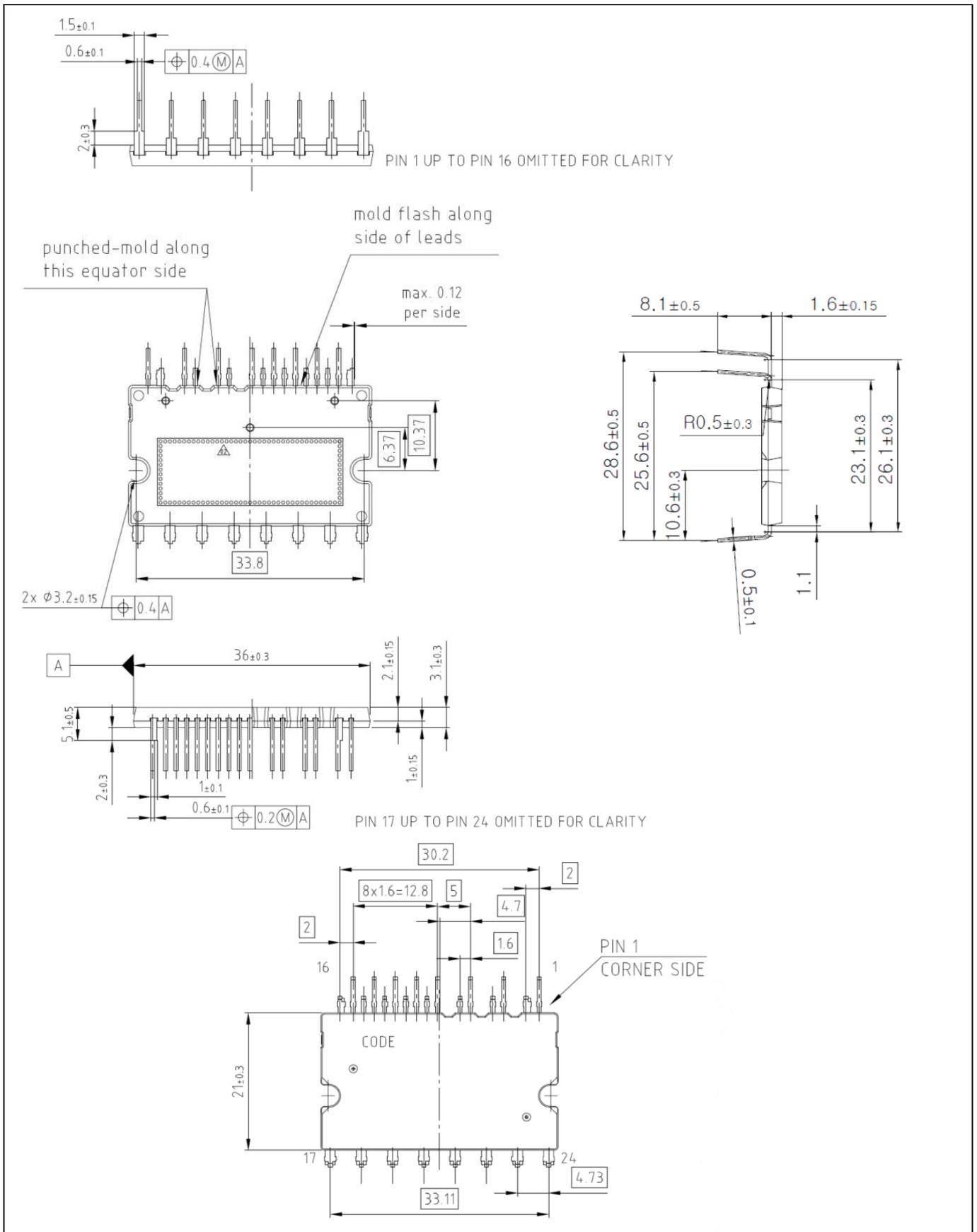


图 13 IM06B50GC1

修订记录

修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
1.00	2024-12-10	Initial release
1.10	2025-02-28	Updated UL number and Figure 13 (package outline)



## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

## 重要通知

版本 2025-12-24

Infineon Technologies AG 出版，  
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG  
及其关联公司。  
保留所有权利。

Do you have a question about this  
document?

Email:

[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。